

★1	需提供全新设备，不允许是翻新设备
2	主机
▲2.1	主机包括曝光系统、对准系统、电控系统及气动控制系统
★2.2	8 英寸向下兼容
●2.3	机箱含 300W 电源、双网口、CPU 基础频率 $\geq 2.9\text{GHz}$ 、 $\geq 16\text{G DDR4}$ 内存、 $\geq 1\text{T}$ 机械硬盘、 $\geq 256\text{G SSD}$ 固态硬盘\DVD ,USB3.0 扩展卡
3	曝光系统
▲3.1	具备无掩膜曝光功能
★3.2	光源类型：相干光源，光强可调节，光源寿命 >30000 小时
★3.3	曝光波长：355nm（中心波长）
★3.4	干涉条纹间距调节范围（即线宽特征尺寸）： $>100\text{nm}\sim 700\text{nm}$
★3.5	单次曝光面积： $>0.8\text{mm}\times 0.8\text{mm}$ ，且长或宽都须 $\geq 0.8\text{mm}$
★3.6	可实现 8 英寸晶圆曝光
★3.7	激光输出稳定性： $\leq 2\%$
★3.8	结合了紫外激光干涉技术和位移、旋转控制技术，可在标准基片上进行紫外光刻胶周期性结构的双光束直接曝光。
★3.9	使用双光束干涉技术实现半导体材料的周期性结构曝光；可通过位移台控制样品移动或转动实现多种结构曝光。
4	对准系统
★4.1	对准精度： $< \pm 0.1\mu\text{m}$
●4.2	CCD+显示器对准，放大倍数： ≥ 4 倍
★4.3	样片加工运动范围：X： $\geq 200\text{mm}$ ；Y： $\geq 200\text{mm}$
●4.4	曝光头工作模式：曝光位、对准位可自动切换
★4.5	样片尺寸：8 英寸，并配置专用样品台
●4.6	硅片厚度：Non-Taiko： $\geq 120\mu\text{m}$

★4.7	位移台运动方式：X、Y、Z、旋转
●4.8	Z 运动范围≥30 mm
●4.9	可绕 Z 轴旋转 360 度
5	电控系统
●5.1	配备专用软件，软件具有工艺参数设置、硬件自我故障诊断与检测功能；具备软件备份功能和权限管理功能
6	气动系统
●6.1	配备减震气浮垫
7	其它附件
●7.1	配备紧急停止按钮（EMO 急停）
●7.2	备品备件：激光防护镜 1 套
●7.3	维护维修专用工具：光学镜组专用内六角扳手 1 套
8	六个月内 PM 需要更换的耗材
●8.1	提供六个月内预防性维护（PM）所需更换的耗材，包括镜片清洁湿巾 1 套、过滤器、密封圈、电极、阀门、卡盘、机械手指、喷嘴、加热管、阀门膜片、泵油、O 型环及研磨垫等关键易损件的供应与更换支持。